

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 10 月 27 日和 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会第二十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《关于 2026 年度担保额度预计的议案》，同意为满足子公司融资需求，公司为合并报表范围内部分子公司（含新设立的子公司）提供担保额度总计不超过 31,000 万元，该额度可循环使用。其中，对公司子公司深圳市和科达半导体设备有限公司（以下简称“和科达半导体”）提供不超过 6,000 万元的担保额度。担保额度的有效期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。公司及子公司经营管理层在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2026 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-050）。

二、担保进展情况

近日，和科达半导体与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签署金额为 500 万元的《综合授信协议》及《流动资金借款合同》，公司就上述《综合授信协议》项下发生的全部债权与光大银行签订《最高额保证合同》，为和科达半导体在上述《综合授信协议》内实际发生的债务本金及利息等费用提供连带责任保证担保。

公司对和科达半导体的担保余额和可用担保额度在本次担保前后变化情况如下：

单位：人民币 万元

| 担保方 | 被担保方 | 经审批的担保额度 | 本次担保前实际担保余额 | 本次担保后实际担保余额 | 已使用担保额度 | 剩余可用担保额度 |
|-----|--------|----------|-------------|-------------|---------|----------|
| 公司 | 和科达半导体 | 6,000 | 0.00 | 500 | 500 | 5,500 |

三、被担保人基本情况

1、基本情况

公司名称：深圳市和科达半导体设备有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5G3CBG0N

成立日期：2020年3月16日

注册地址：深圳市宝安区松岗街道朗下社区茅洲工业区 C3 栋 201

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：陈烨栋

经营范围：一般经营项目：半导体自动化设备、涂佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的研发及销售；承接相关设备的安装工程及技术服务；自营和代理各类商品、半导体耗材及相关技术支持；非标自动化设备的租赁与销售；电子自动化设备的研发与销售；3C 电子耗材、光电设备耗材的销售；机器设备的维修；国内贸易；货物及技术进出口。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：半导体自动化设备、涂佈机、显影机、刻蚀机、去胶机、硅片清洗机、晶圆清洗机、微影光刻机、集成电路的生产设备和测试设备及其他电子设备的生产

控制权关系：公司通过全资子公司深圳市和科达投资有限公司（以下简称“和科达投资”）对和科达半导体的持股比例及表决权比例为 35.66%；和科达投资为深圳和弘华企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和弘华”）的普通合伙人，且和弘华其他股东与和科达投资签订一致行动人协议，将表决权委托给和科达投资，和科达投资对和弘华的持股比例为 1.00%，和弘华对和科达半导体的

持股比例为 11.89%，故和科达投资通过和弘华对和科达半导体的持股比例及表决权比例分别为 0.12%、11.89%；因此公司对和科达半导体合计持股比例及表决权比例分别为 35.78%、47.55%。和科达半导体不设董事会，设董事 1 名，由和科达员工陈焯栋先生担任。基于上述情况，公司在表决权比例为 47.55%的情况下能够对和科达半导体实施控制。

深圳市和科达半导体设备有限公司不属于失信被执行人。

2、财务数据

单位：人民币 元

| 项目 | 2025 年度（经审计） | 2026 年 1-3 月（未经审计） |
|-------|-----------------------|-----------------------|
| 营业收入 | 23,239,514.01 | 16,140.50 |
| 营业利润 | 1,196,418.68 | -704,693.95 |
| 净利润 | 1,227,476.36 | -670,666.81 |
| 项目 | 2025 年 12 月 31 日（经审计） | 2026 年 3 月 31 日（未经审计） |
| 资产总额 | 29,240,827.49 | 25,711,948.77 |
| 负债总额 | 11,798,214.86 | 8,940,002.95 |
| 净资产 | 17,442,612.63 | 16,771,945.82 |
| 资产负债率 | 40.35% | 34.77% |

四、担保合同的主要内容

1、受信人：深圳市和科达半导体设备有限公司

2、授信人：中国光大银行股份有限公司深圳分行

3、保证人：深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

4、保证范围：受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息（包括法定利息、约定利息及罚息）、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、保全费用、鉴定费用、差旅费用、公证费用、执行费用等）和所有其他应付的费用、款项。

5、保证方式：连带责任保证

6、担保金额：人民币 500 万元

7、保证期间：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单

独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年。如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

五、担保的必要性和合理性

1、本次担保主要是为满足和科达半导体经营需要，解决其经营过程中的业务开展和资金需求，符合公司整体利益和发展战略。本次担保金额未超过公司股东会授权的担保额度范围，且被担保对象为公司合并报表范围内正常、持续经营的控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，整体担保风险可控。

2、鉴于控股子公司少数股东的担保资质相对较弱，公司在担保期内将采取措施对被担保方的经营管理风险进行有效控制。公司管理层将密切关注子公司的财务状况，确保财务风险处于可控范围内，以避免对公司的正常经营活动造成不利影响。同时，公司会对控股子公司的经营情况、资产负债率变化以及担保协议的签署等关键事项进行持续监控和管理。公司将通过定期审查和风险评估，及时发现并应对潜在的风险，确保子公司的稳健运营以降低担保风险。综上，公司未要求本次被担保方及其少数股东提供反担保。

六、董事会意见

上述担保额度已经公司第四届董事会第二十一次会议和 2025 年第一次临时股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。和科达半导体为公司控股子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对和科达半导体在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。和科达半导体未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保额度总金额为 8,500 万元(均为公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保),占公司最近一期经审计净资产(24,234.48 万元)的 35.07%;公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 0 万元,占公司最近一期经审计净资产(24,234.48 万元) 0.00%。

除前述担保外,公司无其他对外担保事项;公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

八、备查文件

- 1、和科达半导体与光大银行签署的《综合授信协议》;
- 2、公司与光大银行签署的《最高额保证合同》。

特此公告。

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司

董 事 会

2026 年 6 月 11 日